

# 全国半导体设备和材料标准化 技术委员会材料分技术委员会

半材标委[2025]30号

## 关于召开《氮化铝单晶复合衬底》等11项半导体材料标准 工作会议的通知

各标委会委员、各起草单位及会员单位：

根据国家标准化管理委员会、工业和信息化部及中国有色金属工业协会下达的关于标准制修订计划的文件精神，以及2025年标委会工作安排，现定于2025年10月28日~30日在广东省东莞市召开半导体材料标准工作会议。现将有关事宜通知如下：

### 一、会议内容和资料

会议将对《氮化铝单晶复合衬底》等11项半导体材料标准进行审定、预审和讨论（具体项目见附件）。请标委会委员、各项目的负责起草单位、参加起草单位和相关单位派代表参加会议，项目负责起草单位需携带标准资料。

各标准负责起草单位务必于10月22日前将标准稿件等发送至标委会秘书处邮箱（tc203sc2@cnsmq.com），由秘书处挂网征求意见。各相关单位可于10月24日之后在有色标准信息网（www.cnsmq.com）“标准制定工作站”栏目下载。

### 二、报到时间、地点及乘车路线

1、报到时间：2025年10月28日全天。

2、报到地点：东莞圣佰利国际酒店（东莞万江街道新城社区万道路 123 号 电话：0769-26266666）。

3、乘车路线：①东莞站：乘轨道 2 号线至鸿福路站下车，步行 400 至市民服务中心站，乘 638 路至市总汽车站，步行 200 米到酒店；乘出租车到酒店约 19 公里，约 50 元左右；②东莞东站：步行 700 米至常平站乘广肇广惠城际线至西平西站，步行 900 米至福地站，乘 G13 路至市总汽车站，步行 200 米到酒店；乘出租车到酒店约 46 公里，约 105 元左右。③广州白云机场：乘地铁 3 号线至体育西站（区间终点），同站换乘 3 号线至汉溪长隆站，步行 800 米至广州长隆站，乘广肇广惠城际线至麻涌站，同站换乘 601 路至市总汽车站，步行 200 米到酒店；乘出租车到酒店约 82 公里，约 130 元左右。

### 三、会务及联系人

本次会议由广东天域半导体股份有限公司协办。

标委会秘书处：李素青 010-62565659 15652368697。

会议缴费、发票：孙紫微 010-62257692。

### 四、会议报名及缴费

请参会代表务必于 2025 年 10 月 22 日前登录会议报名系统（<http://www.ysmeeting.net>）注册、完善个人信息、住房需求及单位发票信息后报名。本次会议收取会议费 850 元/人，会议期间食宿统一安排，住宿费自理。为有效保障会议用房安排和会议资料的准备，10 月 22 日之后及现场缴费收取 1200 元/人。汇款请注明：10 月东莞半材会议（个人汇款请备注单位简称及参会代表姓名）。汇款账户信息如下：

收款单位：有色金属技术经济研究院有限责任公司

开户行：中国光大银行北京中关村支行

账号：0875 0812 0100 3010 18526

附件：会议审定、预审和讨论的标准项目

二〇二五年九月三十日



抄报：全国半导体设备和材料标准化技术委员会

附件：

会议审定、预审和讨论的标准项目

序号	组别	计划文号及编号	项目名称	牵头单位	备注
1	第一组	国标委发（2024）28号 20241932-T-469	碳化硅单晶	北京天科合达半导体股份有限公司	审定
2		国标委发（2025）12号 20250822-T-469	200mm 碳化硅单晶抛光片	上海天岳半导体材料有限公司	讨论
3		国标委发（2025）12号 20250729-T-469	碳化硅晶片表面杂质元素含量的测定 电感耦合等离子体质谱法	广东天域半导体股份有限公司	预审
4		国标委发（2025）12号 20250731-T-469	碳化硅外延层载流子寿命的测试 瞬态吸收法	广东天域半导体股份有限公司	预审
5		国标委发（2025）3号 20250151-T-469	碳化硅粉	山西烁科晶体有限公司	预审
6		中色协科字（2025）23号 2025-033-T/CNIA	碳化硅粉表面金属含量的测定 电感耦合等离子体质谱法	山西烁科晶体有限公司	预审
7		国标委发（2025）3号 20250093-T-469	氮化铝单晶复合衬底	松山湖材料实验室	预审
8	第二组	工信厅科函（2025）84号 2025-0027T-YS	再生硅片	中国电子科技集团公司第四十六研究所	审定
9		国标委发（2025）7号 20250575-T-469	高温扩散用硅舟及硅保温筒	杭州盾源聚芯半导体科技有限公司	预审
10		国标委发（2025）7号 20250577-T-469	化学气相沉积用硅喷射管	杭州盾源聚芯半导体科技有限公司	预审
11		国标委发（2025）3号 20250087-T-469	集成电路用高纯硅靶材	宁波江丰电子材料股份有限公司	预审